

东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表  
(2024年11月5日-11月8日)

证券代码：东芯股份

证券简称：688110

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（策略会）
参与单位名称	见附件1
活动时间	2024年11月5日-11月8日
活动地点	策略会
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：蒋雨舟 证券事务代表：黄沈幪 投资者关系：王佳颖
投资者关系 活动主要内容介绍	<p>一、公司近期经营情况介绍</p> <p>公司副总经理、董事会秘书蒋雨舟女士向与会投资者介绍了公司前三季度的经营情况。</p> <p>二、交流的主要问题及答复</p> <p>1、请问公司的1xnm目前是什么进度？ 答：公司先进制程的1xnm SLC NAND Flash产品的研发工作已取得阶段性进展，产品已达成部分关键指标，为确保产品质量与性能稳定，目前正持续进行设计优化和工艺调试等技术攻关工作。</p> <p>2、公司前三季度计提情况如何？ 答：公司前三季度共计提资产减值损失-1,597.77万元。减值幅度同比去年有较大比例下降，主要由于公司面对的下游应用市场逐步回暖，产品市场价格逐步修复。</p> <p>3、公司的NOR Flash产品是什么发展方向？</p>

	<p>答：公司基于 48nm、55nm 制程，持续进行 64Mb-1Gb 的中高容量 NOR Flash 产品研发工作，根据不同容量的目标客户群进行精确定位，保证性能、功耗和性价比的合理匹配。随着公司 NOR Flash 产品持续迭代升级，产品品类不断丰富，将为可穿戴设备、安防监控、物联网、汽车电子等领域的客户提供多样化、高可靠性的产品选择。</p> <p>4、公司目前上游晶圆厂代工价格情况如何？ 答：随着产能挤兑情况的消除，预计下半年代工价格不会有太大变化，整个下半年较为平稳。</p> <p>5、请问在 SLC NAND 领域公司有哪些优势？ 答：从公司的 SLC NAND Flash 产品优势明显，一方面是在产品的品类方面，存储容量覆盖 512Mb 至 32Gb，可灵活选择 SPI 或 PPI 类型接口，搭配 3.3V/1.8V 两种电压，可满足客户在不同应用领域及应用场景的需求。另一方面是产品的可靠性优势，公司产品在耐久性、数据保持特性等方面表现稳定，不仅在工业温控标准下单颗芯片擦写次数已经超过 10 万次，同时可在-40℃-105℃的极端环境下保持数据有效性长达 10 年，产品可靠性已逐步从工业级标准向车规级标准迈进。目前公司对于海外大厂的 SLC NAND Flash 产品能做到 PIN to PIN 的替代。</p>
日期	2024 年 11 月 11 日

附件 1：《参与单位清单》

参与单位名称
光大证券
招商证券
光大保德信
鼎泰四方
招商资管
上海晟盟资产
金鼎资本
国弘集团
中庸资产
浙商证券
国海证券
EBSASSET MANAGEMENT
上海复胜资产
上海日胜隆私募
东吴人寿保险
凯石基金
华泰资管
嘉合基金
宏颐投资

山西证券资管
常春藤
弘毅远方基金
浙商资管
西部证券权益投资部
鑫元基金
长安基金
中泰证券
善正资产
乾融投资